半導体素子の 2D～3D 実装技術動向と狙うべき方向

本多　進 *

Trends of 2D-3D Packaging Technologies for Semiconductor Devices

Susumu HONDA*

* 特定非営利活動法人サーキットネットワーク（〒 236-0046　横浜市金沢区釜利谷西 3-21-18）
*NPO Circuit-Network (21-18, 3 Chome, Kamariya-nishi, Kanazawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa 236-0046)